

INHALT

Oktober 2021



1287

Eutech entwickelt Thermoden-Lötanlage für belgischen Automobilzulieferer: Automatisierte Verkabelung von Sensormatten für Pkw-Lenkräder mit großem Durchsatz und hoher Qualität



1236

Selbsthilfe in der EMS-Welt: Handelsplattform für Bauteil-Überbestände aufgesetzt



1242

KI wird die Elektronik-Industrie stark verändern. Teil 2 des Trendberichts aus den USA



1271

Rechtzeitige strategische Ausrichtung: Trotz Brexit wichtiger Player in Europa

EDITORIAL

Digitalwüste Deutschland – Ist es wirklich so schlimm? 1201

AKTUELLES

NEWS & Trends 1205
 productronica: Anders als gewohnt 1214
 Neues Netzwerk 1227
 Der Integrator geht 1229
 TERMINE & Events 1232

BAUELEMENTE

Elektronikfertiger teilen Überbestände 1236
 Eigenständiges Multiprotokoll-Modul 1238

BAUELEMENTE

Einfache Montage: Snap-in Kondensatoren der Samwha JR-Serie 1238
 Der erste USB-PD-3.1-Mikrocontroller für Hochvolt-Systeme mit höherer Leistung 1239

DESIGN

Künstliche Intelligenz wird die Elektronik-industrie nachhaltig verändern 1242

LEITERPLATTENTECHNIK

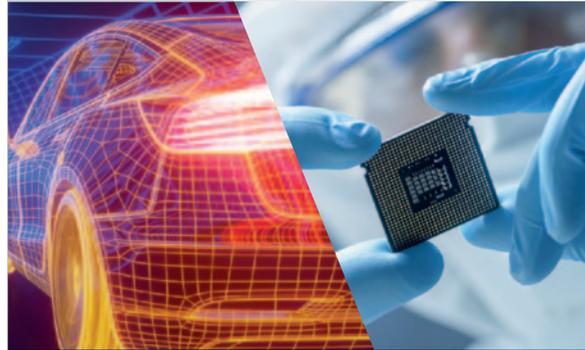
Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrickheit): Elektromobilität bietet viele neue Chancen für Zulieferer 1257
 Fachwissen und Networking 1266
 Aufstieg in die europäische Spitzenliga der PCB-Hersteller 1271



ventec
INTERNATIONAL GROUP
騰輝電子

Qualitativ hochwertige Basismaterialien und Prepregs

Flexible, zuverlässige Supply-Chain-Lösungen



Ventec International Group

Ventec ist Spezialist für die Herstellung von hochwertigen Basismaterialien und Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz liefert kundenspezifische Supply-Chain-Lösungen in allen Regionen der Welt. Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren in China, Großbritannien, Deutschland und USA, ist niemand besser positioniert, um die Bedürfnisse der globalen Leiterplattenindustrie zu bedienen.



productronica 2021
Besuchen Sie uns:

B3.222

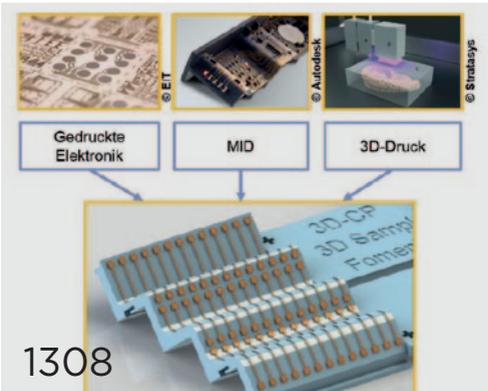


www.ventecamines.com



1298

Datenlogger und Schnittstellen: Für Steuerung und Überwachung von Fertigungsprozessen müssen Daten an den richtigen Stellen gesammelt werden



1308

Additive Fertigungsverfahren für 3D-MID: Mittels Lasersintern Kupferleiterstrukturen auf räumlichen Schaltungsträgern erzeugen

BAUGRUPPEN & SYSTEME

- Automobilelektronikerhersteller setzt seit Jahren auf Produkte eines Maschinenbauers 1284
- Ultradünne Schutzbeschichtung setzt neue Standards 1286
- Innovation zum Anfassen 1287
- Elemaster setzt auf Bestückungsautomaten von FUJI 1290
- Gut durch die Corona-Pandemie gekommen 1292

ANALYTIK & TEST

- Kooperation zur Anbindung von Daten-loggern an Messgeräte 1298
- Omron zeigt neues PCB-Inspektionssystem VT-S10 1300
- Yamaha Motor zeigt neues YRi-V 3D-Hybrid AOI-System 1300
- Modulares Testsystem prüft Batterie-Sicherheitseinrichtungen 1302

PLUS 10/2021 | 1203



Kupfer wird absehbar noch knapper – und bereitet deshalb in der Leiterplatten-Industrie einige Kopfschmerzen

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Generative Erzeugung von Kupferleiterstrukturen mittels Lasersintern auf räumlichen Schaltungsträgern	1308
Förderprojekt für Niedertemperatur-TLP-Bonden gestartet	1310
Patente	1311

FORUM

Plattentektonik	1313
Positive Bilanz nach erstem Online-Event	1316
Knappes Kupfer	1318
Kolumne: Alles über einen Kamm scheren	1326
PLUS-Firmenverzeichnis	1329
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1356
Inserentenindex	1357
Mediadaten	1358
Impressum	1359
Produkt des Monats	1360

Titelbild

FELDER – Zinn aus fairen Ressourcen zur Herstellung von lötechnischen Produkten für höchste Ansprüche. Zinn, bevorzugt von Produzenten, die sich sowohl für ihre Belegschaft in Form von guten Arbeitsbedingungen als auch für die Umweltbedingungen innerhalb der Abbaugelände einsetzen. Der Lohn aller Mitarbeiter muss ausreichend sein, um den Familien eine unbeschwertere Zukunft zu gewährleisten.

Besuchen Sie uns in München zur Productronica 2021:
Halle A4, Stand 381

FELDER GMBH -Löttechnik • D-46047 Oberhausen
Tel.: 0208 85035-0 • www.felder.de

Die Fachzeitschrift PLUS enthält exklusive Mitglieder-Informationen folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente
Distribution e. V.
Tel. +49 8563 9788908
a.falke@fbdi.de, www.fbdi.de

1240



Fachverband Elektronik-Design e. V.
Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

1250



EIPC – Der Europäische
Elektronik-Verband
Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

1262



Fachverband Electronic
Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

1279



Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS
AND PACKAGING SOCIETY –
Deutschland e. V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1294



Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e. V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1304



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0
romina.krieg@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1312